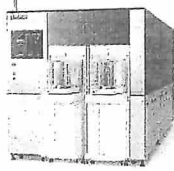




10

半導体パッケージ
樹脂を
全自動研削
(ディスコ)



07

ダイセル、米拠点集約

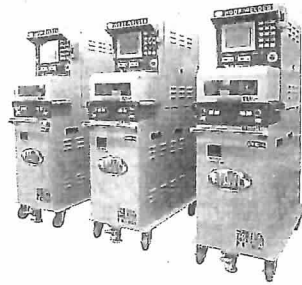
ダイセルは、収益力改善のためエアバッグ用ガス発生装置の米国生産拠点を集約する。

09

接合時間65%削減

ムラタ溶研は、接合時間15秒と65%削減した電子部品向け薄板溶接小型装置を投入。

ムラタ溶研が高効率機



作業者がクランプすれば自動で切断し突き合わせて自動溶接

電子部品製造 セミオート式

ムラタ溶研(大阪市淀川区、村田倫之介社長、06・6390・6768)は、電子部品製造で使用する带状金属薄板(フープ材)溶接小型装置で、接合時間を約15秒と従来比65%削減したセミオートモデルを開発した。リードフレームやコネクタをターゲットに、月内にも発売する。消費税抜きの価格は905万~950万円。2021年に20台の販売を計画する。

带状金属薄板15秒接合

従来装置は溶接が自動で、前工程のクランプ(保持)と切断、金属端突き合わせは手動だった。新装置では作業者がクランプすれば、自動で切断し、サーボモーターで突き合わせして自動溶接する方式にした。

また演算機能を付加し、材料幅を入力すれば溶接の始点と終点が自動で割り出される仕様にして段取り時間も短縮した。同装置はヒューム(粉塵)発生が極めて少なく、21年4月1日に施行される労働安全衛生法施行令改正の適用範囲外だが、作業者の労働環境改善の観点から局所排気装置を標準装備した。第5世代通信(5G)向けや自動車、各種機械・装置の電動化により、リードフレームやコネクタなどの部品需要は拡大しつつある。このためラインの高速化や、より幅広い薄板で複数個をプレスで抜くなど生産方式に変化が起きている。

日刊 THE NIKKAN 工業 KOGYO SHIMBUN 新聞

12月4日 金曜日

2020年(令和2年)